

|| 企業調査レポート ||

## フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

[企業情報はこちら >>>](#)

2023年12月29日(金)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

## 目次

■ 要約	01
1. 2024 年 3 月期第 2 四半期の業績概要	01
2. 2024 年 3 月期の業績見通し	01
3. 中期経営計画の計画値は下方修正したが、2025 年 3 月期の目標値は変えず	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 事業セグメント	03
3. 特色、強み	03
■ 業績動向	04
1. 2024 年 3 月期第 2 四半期の業績概要	04
2. セグメント別概況	05
3. 主な設備投資	06
■ 今後の見通し	07
1. 2023 年 3 月期業績見通し	07
2. 主要製品の現況と見通し	07
■ 中期経営計画と重点施策	09
1. 中期経営計画の進捗	09
2. 今後の重点施策	09
■ 株主還元策	10

## ■ 要約

### 2024年3月期第2四半期の売上高は8.2%増、営業利益は23.6%減。 世界的な半導体市場の低迷の影響を受ける

フェローテックホールディングス<6890>の主力事業は、真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC(化学蒸着法炭化ケイ素)製品、磁性流体、サーモモジュールなどの様々な製品・装置・部品・素材等の製造である。加えて、半導体製造装置メーカー向けに各種部品等の洗浄サービスやシリコンウエーハの研磨なども行う企業である。

#### 1. 2024年3月期第2四半期の業績概要

2024年3月期第2四半期決算は、売上高が前年同期比8.2%増の105,494百万円、営業利益が同23.6%減の13,035百万円、経常利益が同35.4%減の15,217百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同47.5%減の8,390百万円となった。売上高はほぼ計画どおりであったが、製品構成の変化により営業利益は期初予想(15,000百万円)から未達となった。事業別では、世界的な半導体業界での生産調整や設備投資抑制の影響を受けて、半導体等装置関連の売上高は60,257百万円(前年同期比5.5%減)、セグメント利益は7,788百万円(同33.5%減)となった。また電子デバイスでは、パワー半導体用基板が大きく寄与して売上高は32,840百万円(同42.3%増)、セグメント利益は6,080百万円(同14.2%増)となったが、半導体等装置関連の利益の落ち込みをカバーするには至らなかった。さらに営業外において、為替差益が1,727百万円(前年同期は5,198百万円)と減少したこと、持分法による投資損失が1,324百万円(同249百万円)となったことなどから経常利益の減益幅は大きくなった。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に特別利益として計上した持分変動利益618百万円が剥落したことに加え、投資有価証券評価損495百万円を計上したことなどから減益幅はさらに大きくなった。

#### 2. 2024年3月期の業績見通し

2024年3月期通期の業績は、現時点で売上高220,000百万円(前期比4.4%増)、営業利益27,000百万円(同23.0%減)、経常利益28,000百万円(同34.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益15,000百万円(同49.5%減)と予想している。売上高の予想は期初と変わっていないが、営業利益は期初予想(32,500百万円)から下方修正された。これは、現在の市況において利益率の高い製品の売上構成比が下がると見られるためだ。下期に入っても、半導体業界を取り巻く環境に大きな変化はなく、同社製品に対する需要が本格的に回復するのは来期以降と見られるが、現時点で下方修正されたこの予想が達成される可能性は高いだろう。通期での投資額は96,900百万円(前期は62,661百万円)、減価償却費は17,400百万円(同12,618百万円)と計画している。

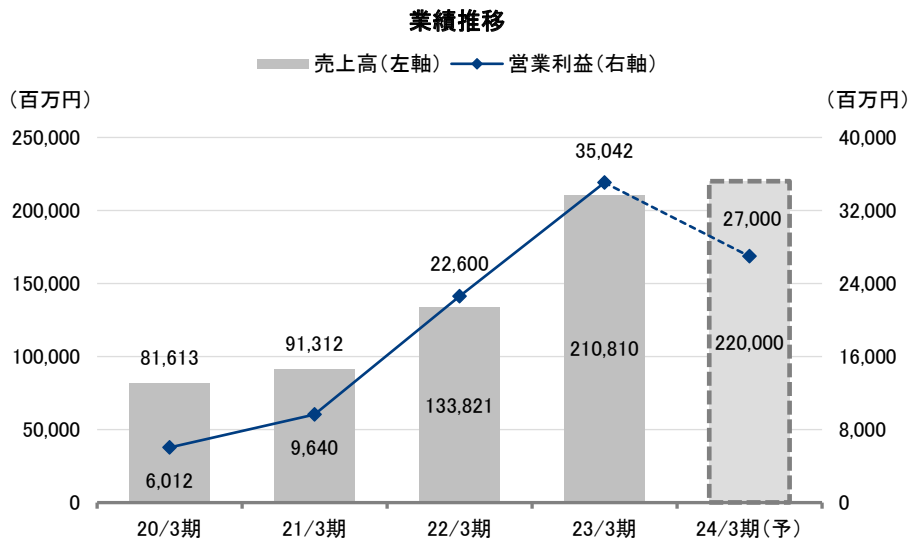
## 要約

**3. 中期経営計画の計画値は下方修正したが、2025年3月期の目標値は変えず**

同社は、2024年3月期を最終年度とする中期経営計画を発表していた。主要製品の需要動向に合わせて何度か修正を行ったが、現時点での計画値は前述のように売上高2,200億円、営業利益270億円（営業利益率12.3%）となっている。さらに目標値（計画値ではない）として2025年3月期に売上高2,700億円、営業利益450億円、2026年3月期に売上高3,600億円、営業利益600億円を発表しているが、今のところこの目標値は変わっていない。今後は、2024年3月期が終了した時点で新たな「中期経営計画」が発表されるものと思われ、どのような計画になるのか注視する必要があると見られる。

**Key Points**

- ・石英、セラミックス等の無機系製品の大手メーカー。半導体業界向けが多い
- ・2024年3月期第2四半期の営業利益は前年同期比23.6%減、通期予想も23.0%減へ下方修正
- ・中期経営計画値も下方修正だが、2025年3月期以降の目標値を変えず



出所：決算短信よりフィスコ作成

## ■ 会社概要

### 主要顧客は大手半導体デバイス及び同製造装置メーカー

#### 1. 会社概要

同社は2023年3月末時点で傘下に連結子会社73社、持分法適用子会社9社を擁する純粋持株会社である。元々は1980年に米国 Ferrofluidics Corporation (現 Ferrotec (USA) Corporation) の日本法人「日本フェローフリュイディクス株式会社」として設立したが、その後、親会社から分離独立し独自路線を歩んでいる。

現在の主力事業は、真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC 製品、磁性流体、サーモモジュールなど主に無機材料を使った様々な製品・装置・部品・素材等の製造である。加えて、半導体製造装置メーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。

#### 2. 事業セグメント

前述のように同社は多くの製品を自社開発・製造すると同時に M&A によって多くの企業を子会社化してきたことから、事業内容は多岐にわたる。事業セグメントは、半導体等装置関連 (2023年3月期の売上比 62.7%)、電子デバイス (同 25.2%)、その他 (同 12.1%) の3つに分けられており、それぞれサブセグメントが置かれている。

#### 3. 特色、強み

##### (1) 無機系素材のパイオニア

同社は石英、シリコン、窒化ケイ素、シリコンカーバイド (SiC) など幅広い無機系素材の生成・加工などに長年携わってきた。そのため、社内にはこれらの素材に関する多くのノウハウ (素材の性質、生成方法、加工方法等) が蓄積されており、これが同社の特色かつ強みと言えるだろう。

##### (2) 製造装置も手掛ける

同社は、単に素材だけでなく各種の製造装置も手掛けており、製造装置に関するノウハウも持っている。そのため顧客に対し、素材・加工部品・最終製品・製造装置など様々な提案 (ソリューションの提供) を行うことができる。

##### (3) ワンストップソリューションが可能

同社は、半導体製造装置内の部品の洗浄 (取り外し・洗浄・据付) や製造装置の組立等のサービス事業も展開している。顧客にとっては素材の供給、部品加工、装置類の組立、部品洗浄などをワンストップで外注化 (アウトソーシング) することが可能であり、これも同社の強みと言える。

##### (4) 大手顧客との信頼関係

同社の主要製品は、主に半導体製造装置向け及び半導体製造プロセスで使われるため、同社の主要顧客は世界でトップクラスの半導体製造装置メーカーも多い。同社はこれらの大手半導体製造装置メーカーに長年にわたって製品や部品を供給しており、これら顧客との深い信頼関係も同社の財産であり強みとなっている。

## 業績動向

### 2024年3月期第2四半期は世界的な半導体市況低迷により減益

#### 1. 2024年3月期第2四半期の業績概要

##### (1) 損益状況

2024年3月期第2四半期決算は、売上高が前年同期比8.2%増の105,494百万円、営業利益が同23.6%減の13,035百万円、経常利益が同35.4%減の15,217百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同47.5%減の8,390百万円となった。売上高はほぼ計画どおりであったが、営業利益は期初予想(15,000百万円)から未達となった。

事業別では、世界的な半導体業界での生産調整や設備投資抑制の影響を受けて、半導体等装置関連の売上高は60,257百万円(前年同期比5.5%減)、セグメント利益は7,788百万円(同33.5%減)となった。また電子デバイスでは、パワー半導体用基板が大きく寄与して売上高は32,840百万円(同42.3%増)となったが、製品構成の変化によりセグメント利益は6,080百万円(同14.2%増)に留まった。電子デバイスは増益となったが、半導体等装置関連の利益の落ち込みをカバーするには至らなかった。

さらに営業外において、為替差益が1,727百万円(前年同期は5,198百万円)と減少したこと、持分法による投資損失が1,324百万円(同249百万円)と増加したことなどから経常利益の減益幅は大きくなった。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に特別利益として計上した持分変動利益618百万円が剥落したことに加え、投資有価証券評価損495百万円を計上したことなどから減益幅はさらに大きくなった。

#### 2024年3月期第2四半期業績

(単位：百万円)

	23/3期2Q		24/3期2Q		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	増減率
売上高	97,505	100.0%	105,494	100.0%	7,989	8.2%
売上総利益	34,538	35.4%	34,311	32.5%	-227	-0.7%
販管費	17,476	17.9%	21,276	20.2%	3,800	21.7%
営業利益	17,061	17.5%	13,035	12.4%	-4,026	-23.6%
経常利益	23,554	24.2%	15,217	14.4%	-8,337	-35.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	15,979	16.4%	8,390	8.0%	-7,589	-47.5%
投資額※	29,909	30.7%	36,291	34.4%	6,382	21.3%
減価償却費	5,596	5.7%	7,913	7.5%	2,317	41.4%

※ 投資額 = 有形固定資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

## 高水準の設備投資により有形固定資産、有利子負債が増加

### (2) 財務状況

2024年3月期第2四半期末の財務状況は、流動資産が246,956百万円(前期末比31,615百万円増)となった。主に現金及び預金の増加16,937百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加4,896百万円、たな卸資産の増加8,188百万円による。現金及び預金が大幅増となったのは、主に中国子会社の第三者割当増資による増加(6,900百万円)である。固定資産は前期末比で34,313百万円増加し229,619百万円となった。主にマテリアル製品(石英、セラミックス、シリコンパーツ)、パワー半導体用基板、石英坩堝等の増産投資を実施したことによる有形固定資産の増加31,609百万円、無形固定資産の減少291百万円(主に連結子会社による「のれん」の減少102百万円)、投資その他資産の増加2,996百万円(関係会社株式の増加975百万円、その他投資の増加2,050百万円など)による。その結果、資産合計は476,576百万円(同65,928百万円増)となった。

負債合計は、204,741百万円(同43,750百万円増)となった。要因として、電子記録債務を含む支払手形及び買掛金の減少4,209百万円、1年内償還予定の社債と1年内返済予定の長期借入金を含む短期借入金等の増加6,086百万円、社債の減少3,399百万円、転換社債型新株予約権付社債の増加25,000百万円、長期借入金の増加19,029百万円等による。また純資産合計は、271,834百万円(同22,178百万円増)となった。親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加5,810百万円、円安進行に伴う為替換算調整勘定の増加9,945百万円、中国子会社への第三者割当増資による非支配株主持分の増加5,978百万円等によるものである。この結果、2024年3月期第2四半期末の自己資本比率は42.0%(前期末は44.7%)となった。

### 2. セグメント別概況

セグメント別では、主力の半導体等装置関連は売上高60,257百万円(前年同期比5.5%減)、営業利益7,788百万円(同33.5%減)、電子デバイスは売上高32,840百万円(同42.3%増)、営業利益6,080百万円(同14.2%増)、その他は売上高12,396百万円(同16.5%増)、営業損失179百万円(前年同期は398百万円の利益)となった。

フェローテックホールディングス | 2023年12月29日(金)  
6890 東証スタンダード市場 | <https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

## 業績動向

## セグメント別売上高・営業利益

(単位：百万円)

	23/3 期 2Q		24/3 期 2Q		前年同期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	97,505	100.0%	105,494	100.0%	7,988	8.2%
半導体等装置関連	63,791	65.4%	60,257	57.1%	-3,534	-5.5%
真空シール・金属加工	12,833	13.2%	11,730	11.1%	-1,103	-8.6%
石英製品	13,983	14.3%	11,584	11.0%	-2,399	-17.2%
シリコンパーツ	9,325	9.6%	7,712	7.3%	-1,613	-17.3%
セラミックス	13,030	13.4%	11,657	11.0%	-1,373	-10.5%
CVD-SiC	1,962	2.0%	2,999	2.8%	1,037	52.9%
EB ガン・LED 蒸着装置	3,907	4.0%	3,011	2.9%	-896	-22.9%
再生ウエーハ	737	0.8%	796	0.8%	59	8.0%
装置部品洗浄	5,939	6.1%	5,424	5.1%	-515	-8.7%
石英坩堝	2,075	2.1%	5,341	5.1%	3,266	157.5%
電子デバイス	23,073	23.7%	32,840	31.1%	9,767	42.3%
サーモモジュール	11,546	11.8%	10,640	10.1%	-906	-7.8%
パワー半導体	7,919	8.1%	16,103	15.3%	8,184	103.3%
磁性流体・その他	485	0.5%	398	0.4%	-87	-17.8%
センサー (大泉製作所)	3,123	3.2%	5,697	5.4%	2,574	82.5%
その他	10,640	10.9%	12,396	11.8%	1,756	16.5%
営業利益	17,061	17.5%	13,035	12.4%	-4,026	-23.6%
半導体等装置関連	11,707	18.4%	7,788	12.9%	-3,919	-33.5%
電子デバイス	5,325	23.1%	6,080	18.5%	755	14.2%
その他	398	3.7%	-179	-1.4%	-577	-
調整額	-369	-	-654	-	-285	-

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

## 3. 主な設備投資

投資額（有形固定資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計）は 36,291 百万円（前年同期は 29,909 百万円）となった。各事業の積極投資を継続、主な投資内容は、マレーシアの石英・セラミックス工場に 51 億円、常山のセラミックス・シリコンパーツに 57 億円、四川のパワー基板に 38 億円、銀川の石英坩堝等に 46 億円等であった。減価償却費は 7,913 百万円（同 5,596 百万円）となった。



## ■ 今後の見通し

### 2024年3月期営業利益は下方修正され270億円予想。 半導体等装置関連が減収減益、電子デバイスは増益だが伸び率低い

#### 1. 2024年3月期業績見通し

2024年3月期通期の業績は、現時点で売上高220,000百万円（前期比4.4%増）、営業利益27,000百万円（同23.0%減）、経常利益28,000百万円（同34.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益15,000百万円（同49.5%減）と予想されている。売上高の予想は期初と変わっていないが、上半期の状況を受けて営業利益は期初予想（32,500百万円）から下方修正された。これは、現在の市況において利益率の高い製品の売上構成比が下がると見られるためだ。下期に入っても、半導体業界を取り巻く環境に大きな変化はなく、同社製品に対する需要が本格的に回復するのは来期以降と見られるが、現時点で下方修正されたこの予想が達成される可能性は高いだろう。通期での投資額は96,900百万円（前期は62,661百万円）、減価償却費は17,400百万円（同12,618百万円）と計画している。

セグメント別売上高は、半導体等装置関連は126,677百万円（前期比4.2%減）を予想。真空シール・金属加工、半導体材料製品とも、半導体マーケット低迷により受注大幅減少、中国顧客拡大及び石英坩堝、CVD-SiCによる挽回を図るが、前期比で減収を見込む。

電子デバイスは68,009百万円（同28.3%増）を予想。電子デバイスは、パワー半導体基板の売上拡大が継続し、センサの大泉製作所<6618>の連結化効果もあり、増収を見込んでいる。

その他は25,315百万円（同1.1%減）を予想している。

#### 2. 主要製品の現況と見通し

##### (1) 真空シール・金属加工

半導体製造装置メーカーの半導体製造装置の生産は引き続き低迷し、常山工場等の稼働が低迷する見込みで、売上高は前期比14.0%減の24,046百万円を予想している。

##### (2) 半導体材料（石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC）

石英は、半導体生産の低迷、顧客在庫の積み上がりにより受注が急減。中国向けの拡大、需給底堅い火加工生産増強により売上挽回を進めるも、稼働が低下し売上高は27,252百万円（同5.5%減）の見込み。

シリコンパーツも石英と同様に半導体生産・装置生産の低迷から顧客在庫が積み上がり、受注は急減している。売上高は、14,310百万円（同18.4%減）の見込み。

## 今後の見通し

セラミックスも半導体装置生産の低迷、顧客の在庫積み上がりにより受注減少。売上高は23,361百万円（同14.1%減）の予想。CVD-SiCは需給が底堅く、岡山工場の増産により売上は拡大の見通しで6,239百万円（同29.7%増）となる見込み。

**(3) 装置部品洗浄**

半導体生産低迷の影響から需要が減少し、売上高は11,451百万円（同5.9%減）を見込む。

**(4) 石英坩堝**

大型石英坩堝の太陽光発電向けの引き合いが急増しており、売上高は12,091百万円（同210.7%増）と大幅増の見込み。

**(5) サーモモジュール**

ChatGPT関連の引き合いは増加するものの、通信機器向けや医療検査機器向けが一服し、売上高は前期比8.7%減の21,233百万円となる見込み。

**(6) パワー半導体用基板**

DCB基板及びAMB基板の成長が継続。EV・自動車向けの需要が好調で増産投資の効果により大幅増収を見込む。売上高は前期比72.8%増の34,584百万円を予想している。

**(7) センサ**

大泉製作所の連結化（2022年6月）により増加予想であり、売上高は前期比28.0%増の11,282百万円の見込み。

## ■ 中期経営計画と重点施策

### 中期経営計画の計画値（2024年3月期）は下方修正だが、 2025年3月期の目標値（営業利益450億円）は変えず

#### 1. 中期経営計画の進捗

##### (1) 数値目標

同社は、2024年3月期を最終年度とする中期経営計画を発表している。この中期経営計画の当初の定量的目標は、2023年3月期に売上高1,250億円、営業利益190億円、さらに最終年度となる2024年3月期は売上高1,500億円、営業利益250億円が目標であった。しかし2022年3月期、2023年3月期の業績が予想以上に好調であったことから、2024年3月期の計画値を売上高2,300億円、営業利益400億円に上方修正した。しかしその後、記述のように半導体業界を取り巻く環境が急速に悪化したことから、現時点ではこの目標を、売上高2,200億円、営業利益270億円、営業利益率12.3%、ROE15%目標に下方修正した。残り6ヶ月を切った現時点での予想であるため、これらが達成される可能性は高いと思われる。また前回から、新たに2025年3月期の目標値（計画値ではない）として売上高2,700億円、営業利益450億円を発表しているが、この目標値に変更はない。

##### (2) 設備投資

設備投資計画については、2022年3月期から2024年3月期までの3年間で1,950億円の設備投資をするとして発表していたが、現時点でこの計画に変更はないようだ。既に2022年3月期に354億円、2023年3月期は627億円の設備投資を行っており、2024年3月期は969億円の投資を行う計画としている。

この1,950億円の投資については、短期・中期で約1,300億円を計画している。主に半導体分野、電子デバイス等を中心に市場拡大の機会を捉え、生産力増強へ積極的に投資する。その一方で、長期的な収益に貢献する「長期的な投資」に約650億円を計画している。主に、1) 半導体分野の製品レンジ拡充、2) EV、新エネルギー車関連、3) 新たな柱となる事業への投資、4) 事業関連性や潜在的成長力等に照らしたM&A、などに投資する計画だ。M&Aへの投資額は投資機会により変動するが、3年以内にROICを5%以上とすることができるM&Aを検討する予定だ。これらの方針は変わっていない。

#### 2. 今後の重点施策

同社では、中期経営計画の推進と合わせて、今後の重点施策として、1) 生産拠点のグローバル化、2) 生産現場での「デジタル化・自動化・見える化」、3) 事業ポートフォリオの強化（非半導体製造装置分野の事業拡大）を掲げている。

##### (1) 生産拠点のグローバル化

これまでの同社は、中国を中心に事業を積極的に展開してきたが、米中経済摩擦や地政学的リスクを考慮し、生産拠点のグローバル化を図る。

## 中期経営計画と重点施策

**1) マレーシア**

2022年4月に設立したマレーシアのケダ州クリム・ハイテクパーク内（ペナン島近隣）の製造子会社 Ferrotec Manufacturing Malaysia に新工場を建設中である。2024年1月竣工予定だ。東南アジア顧客に密着した事業展開（石英製品・セラミックス・金属加工/組立等）を図る。

**2) 日本（石川県）**

中長期での需要拡大が見込まれる半導体製造装置関連部材「ファインセラミックス」「マシナブルセラミックス」の増産を石川エリアで対応している。2022年11月に第2工場が竣工、第3工場も用地を確保済で2025年前半の竣工を目指している。

**3) 日本（熊本県）**

「シリコンアイランド」九州の熊本県大津町に生産拠点を新設予定。既に2023年9月に着工し、2024年中の竣工を予定している。現在、新拠点で事業展開する半導体関連製品、サービスを検討している。

**(2) 「デジタル化・自動化・見える化」の水平展開**

中国の生産拠点でERP、MESをはじめ、様々なシステム導入が進み、生産の見える化、効率化、品質の向上が実現（例：AI活用、ロボットの積極導入）した。今後は、日本やマレーシアの新拠点でもこれらの自動化投資（水平展開）を積極的に進める。

**(3) 非半導体製造装置分野における事業拡大**

電子デバイス事業では、従来から多業界で採用が拡大する温調デバイス「サーモモジュール」に加えて、世界的な省エネ化トレンドに沿った「パワー半導体用絶縁基板」が大きな事業の柱に成長しており、今後も注力する。また新たに連結子会社に加わった大泉製作所、東洋刃物（株）も中期的に事業拡大を目指し、非半導体製造装置の比率を高める。

なお、連結子会社である大泉製作所（出資比率51.0%）を完全子会社化するため、株式の公開買付けをすることを発表済み（2023年11月10日開示）。買付価格は、1株当たり1,300円、取得価額59億円を前提に約59億円を予定している。

## 株主還元策

### 当面は積極的な設備投資優先も、将来はさらなる増配に期待

同社は株主還元策として配当を実施している。2021年3月期は記念配当を含めて30円の配当を行い、2022年3月期は50円の配当を行った。さらに2023年3月期は、好調な業績に伴い年間105円（中間50円、期末55円）を行った。進行中の2024年3月期は、年間100円（中間50円、期末50円、予想配当性向31.3%）を予定している。

同社は「今後は、投資拡大のため配当性向は下がるものの、収益性改善に応じた安定配当による最大限の株主還元を目指す」と述べており、利益水準によってはさらなる増配の可能性もありそうだ。

#### 重要事項（ディスクレマー）

株式会社フィスコ（以下「フィスコ」という）は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。

本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したのですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受けて作成されていますが、本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは堅く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

#### ■お問い合わせ■

〒107-0062 東京都港区南青山 5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443（IR コンサルティング事業本部）

メールアドレス：support@fisco.co.jp